

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2008年10月23日 (23.10.2008)

PCT

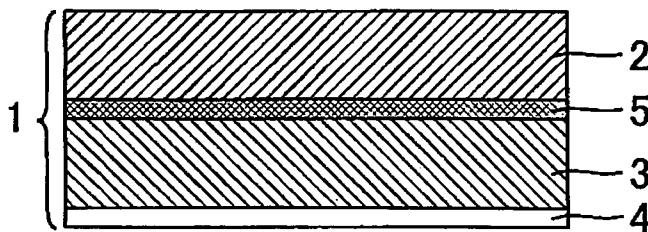
(10) 国際公開番号
WO 2008/126938 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 85/38 (2006.01) B65D 73/02 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01) B65D 85/86 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/057389
- (22) 国際出願日: 2008年4月9日 (09.04.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-104052 2007年4月11日 (11.04.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平松 正幸 (HIRAMATSU, Masayuki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 八木 敏安 (YAGI, Toshiyasu); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番19号 第7新大阪ビル 602号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT PACKING BODY

(54) 発明の名称: 電子部品包装体

図 1



composed of an electronic component packing carrier tape wherein the electronic component is stored, and an electronic component packing cover tape. A layer of the cover tape to be brought into contact with the carrier tape includes an adhesive resin (A), and an electrostatically chargeable resin (B) which is electrostatically charged reversely to the electrostatic charging polarity, which is of the adhesive resin (A) and generated by friction between the adhesive resin (A) and the electronic component.

(57) Abstract: Provided is an electronic component packing body which can prevent adhesion of an electronic component to a cover tape due to static electricity (pickup failure and the like) and component breakage due to ESD, by suppressing static electricity generated by friction between a stored electronic component (especially a small and light weight electronic component) and the cover tape. The electronic component packing body is

(57) 要約: 収納された電子部品(特に、小型・軽量電子部品)及びカバーテープ間の摩擦による静電気の発生を抑制することにより、その静電気に起因する電子部品のカバーテープへの付着(ピックアップ不良等)やESDによる部品破壊を防止することが可能な電子部品包装体を提供する。電子部品を収納した電子部品包装用キャリアテープと電子部品包装用カバーテープとからなる電子部品包装体であって、上記カバーテープのキャリアテープと接する層は、接着性樹脂(A)、並びに、上記接着性樹脂(A)及び上記電子部品の摩擦時に生じる上記接着性樹脂(A)の帯電極性と逆に帯電する電荷帯電性樹脂(B)を含む電子部品包装体である。

WO 2008/126938 A1